



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120220002

2012 年 2 月 21 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

PWR LBC7 プロセス 一部製品 前処理サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☒ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	PWR LBC7プロセス 一部製品 前処理サイト追加 現行 : TI-FFAB(ドイツ) 変更後: TI-FFAB(ドイツ), TI-RFAB(米国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	6月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: 弊社 PWR(パワーマネジメント) LBC7プロセス 一部製品の前処理サイトについて、現行 TI-FFAB(ドイツ)サイトにおいて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-RFAB(米国)サイトを追加します。TI-RFAB前処理サイトにおけるLBC7プロセス製品の製造は認定されています。下記信頼性試験結果(2010年10月6日終了)を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
LBC7プロセス前処理サイト	TI-FFAB(ドイツ)	TI-FFAB(ドイツ) TI-RFAB(米国)
ウェーハ径	200 mm	300 mm

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
SN1010007RSLR	TPS650702RSLR	TPS65071RSLR	TPS65072RSLR	TPS650732RSLR
SN1010007RSLT	TPS650702RSLT	TPS65071RSLT	TPS65072RSLT	TPS650732RSLT
TPS650701RSLR	TPS65070RSLR	TPS650721RSLR	TPS650731RSLR	TPS65073RSLR
TPS650701RSLT	TPS65070RSLT	TPS650721RSLT	TPS650731RSLT	TPS65073RSLT

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト・生産国記号(ラベルの"20L/21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は下記のようになります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	TI-FFAB	TI-RFAB
CSO (20L): 前処理サイト記号	TID	RFB
CCO (21L): 生産国記号	DEU	USA



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年10月6日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	TPS51217DSC	-	-	
Wafer Fab Site:	RFAB	Wafer Fab Process:	LBC7	
Metallization:	TiN/AICu.5/TiN	Wafer diameter:	300 mm	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot1	Lot2	Lot3
Electrical Char.	-	Approved	Approved	Approved
Latch-up	per JESD78	6/0	6/0	6/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
Post Temp Cycle SAM	CSAM & TSAM after 1000 cyc T/C	Approved	Approved	Approved
ESD HBM	2000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Wafer Fab MQ	Per site spec	Approved	-	-
Assembly / Test MQ	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Wafer level Reliability	Approved by TDQRE	Approved	-	-
High Temp. Storage Bake	170C, 168, 420 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
Steady-state Life Test	135C, 110, 320, 635 Hrs	77/0	77/0	77/0
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				